

Judul:

Pengaruh waktu celup H 13 dengan penambahan 0,3% wt dan 0,5 % wt Mn pada paduan Al - Si terhadap pembentukan lapisan intermetelik pada fenomena die soldering

Pengarang/Penulis:

Riski Anggri Wirawan, author

Subjek:

Nomor Panggil:

S41753

Penerbitan:

Fakultas Teknik Universitas Indonesia

Link Terkait:

- [Deskripsi Bibliografi](#)
- [Dokumen Yang Mirip](#)
- [Universitas Indonesia Library](#)